证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20250618

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称 及人员姓名	宝盈基金：游凡、诸晓琳、宋可嘉，共 3 名投资者及证券人员
时间	2025 年 6 月 18 日下午 13:30-14:30
地点	公司 9 楼会议室
上市公司接待 人员姓名	董事、董事会秘书兼副总经理杨平彩女士
投资者 关系活动 主要内容 介绍	<p>管理层介绍公司基本情况，并与投资者就公司半导体业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p>问 1：请问公司抛光垫业务进展如何？</p> <p>答：公司 CMP 抛光垫产品深度渗透国内主流晶圆厂客户，除此以外，在积极进行外资晶圆厂商市场的推广，铜制程抛光硬垫产品已在某主流外资逻辑厂商测试通过并取得小批量订单，并与更多本土外资及海外客户紧密接洽推广中，努力开拓 CMP 抛光垫新的市场增长曲线。同时，公司进一步丰富抛光垫产品布局品类，在硅晶圆及碳化硅市场进行积极探索，拓宽市场，成功取得国内主流的硅晶圆厂家订单，产品种类持续丰富，竞争力得到显著提升。</p> <p>问 2：请问公司研发布局情况如何？</p> <p>答：公司在半导体业务销售收入高速增长的基础上，也持续积极进行半导体材料产品布局的扩展和更新迭代。如在 CMP 抛光材料领域，公司全面布局以碳化硅为代表的化合物半导体用抛光垫，铜及阻挡层抛光液等多款新产品在客户端验证进度不断推进；在半导体显示材料领域，公司无氟光敏聚酰亚胺(PFAS Free PSPI)、黑色光敏聚酰亚胺(BPDL)、薄膜封装低介电材料(LowDKINK)、PI 取向液等新产品的开发、验证持续推进；半导体先进封装材料及高端晶圆光刻胶业务的产品开发、验证评价及市场拓展也在按公司预期进度快速推进中。2024 年，公司研发投入金额 4.62 亿元，较上年同期增长</p>

	<p>21.01%，占营业收入的比例为 13.86%。为各类新产品及配套资源的快速布局提供了坚实的支撑，创新材料与技术的平台化布局持续完善，综合创新能力得到进一步巩固与提升。</p> <p>问 3：半导体显示材料今年增长情况怎么样？</p> <p>答：公司围绕柔性 OLED 显示屏幕制造用的上游核心“卡脖子”材料布局，推出黄色聚酰亚胺浆料 YPI、光敏聚酰亚胺浆料 PSPI、薄膜封装材料 TFE-INK 等系列产品，同时对标国际一流共同探索未来显示技术工艺路线及相应材料应用方向，努力成为新型显示前沿技术的创新材料支持商。2025 年第一季度，公司半导体显示材料实现产品销售收入 1.3 亿元，同比增长 85.61%，环比增长 8.48%。目前，公司 YPI、PSPI、TFE-INK 产品已在客户端规模销售，并已成为国内部分主流显示面板客户 YPI、PSPI 产品的第一供应商，确立 YPI、PSPI 产品国产供应领先地位。公司将持续提升显示材料产品在国内市场的市占率水平。</p> <p>问 4：公司关于显示材料的生产布局进展怎么样？</p> <p>答：生产布局方面，公司会前瞻性进行产能储备：YPI 产品在仙桃实施年产 800 吨 YPI 二期项目建设，计划近期即将完工试运行，以缓解武汉本部 YPI 一期产能压力，满足未来持续增长的产品订单供应；PSPI 产品在仙桃产业园年产 1,000 吨的产线于 2024 年上半年正式投入使用并开始批量供货，生产体系能力提升。</p> <p>问 5：公司光刻胶新品的业务情况怎么样？</p> <p>答：公司已布局 20 余款高端晶圆光刻胶，已有 12 款送样客户端验证，其中 7 款进入加仑样阶段，整体测试进展顺利。2024 年度，公司已有两款光刻胶产品分别收到共两家国内主流晶圆厂客户的订单。光刻胶的后续订单情况，请您持续关注公司后续公告。</p> <p>问 6：公司自主布局上游核心原材料，有哪些优势？</p> <p>答：公司坚持材料技术创新与上游原材料自主化培养同步，持续提升公司产品上游供应链的自主化程度。如 CMP 抛光垫核心原材料—预聚体、微球、缓冲垫，CMP 抛光液核心原材料研磨粒子，晶圆光刻胶的特殊功能单体、树脂、光产酸剂等均已实现国产化或自主化。供应链自主化有助于保障公司产品生产的自主可控、安全稳定，满足半导体行业客户对供应安全、品质稳定的核心诉求，并能在大规模量产阶段带来潜在的材料成本优势，此外供应链自主化也有助于从原料入手对产品进行定制开发，从而提升公司半导体材料产品的市场竞争力。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 6 月 18 日